

「パレット HG（基材、ボンド）」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

基材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材（珪砂、寒水石）	60～75
無機質粉体（炭酸カルシウム 等）	20～30
無機質顔料（酸化チタン）	<10
無機質添加剤（防錆剤）	<1
※ 有機質添加剤（増粘剤、防かび剤 等）	※ <2
※ 有機質繊維（パルプ）	※ <2

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

無機質分 >97.0% 有機質分 <3.0%

合成樹脂エマルション(ボンド)

構成材料名	配合率(重量%)
※ アクリル系水性エマルション(固形分)	※ 38～42
水	48～52
※ 有機質添加剤	※ <10

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

有機質分 48～52% 水分 48～52%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上